

股票代碼：5425

台灣半導體股份有限公司及子公司
合併財務報告暨會計師核閱報告
民國一一年及一〇年第二季

公司地址：新北市新店區北新路三段205號11樓
電話：(02)89131588

目 錄

項 目	頁 次
一、封 面	1
二、目 錄	2
三、會計師核閱報告書	3
四、合併資產負債表	4
五、合併綜合損益表	5
六、合併權益變動表	6
七、合併現金流量表	7
八、合併財務報告附註	
(一)公司沿革	8
(二)通過財務報告之日期及程序	8
(三)新發布及修訂準則及解釋之適用	8~9
(四)重大會計政策之彙總說明	9~11
(五)重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源	11
(六)重要會計項目之說明	11~35
(七)關係人交易	35
(八)質押之資產	36
(九)重大或有負債及未認列之合約承諾	36
(十)重大之災害損失	36
(十一)重大之期後事項	36
(十二)其 他	36~37
(十三)附註揭露事項	
1.重大交易事項相關資訊	37~40
2.轉投資事業相關資訊	40~41
3.大陸投資資訊	41
4.主要股東資訊	42
(十四)部門資訊	42~43



安侯建業聯合會計師事務所
KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel + 886 2 8101 6666
傳真 Fax + 886 2 8101 6667
網址 Web home.kpmg/tw

會計師核閱報告

台灣半導體股份有限公司董事會 公鑒：

前言

台灣半導體股份有限公司及其子公司民國一一一年及一一〇年六月三十日之合併資產負債表，與民國一一一年及一一〇年四月一日至六月三十日及一一一年及一一〇年一月一日至六月三十日之合併綜合損益表，暨民國一一一年及一一〇年一月一日至六月三十日之合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師核閱竣事。依證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可並發布生效之國際會計準則第三十四號「期中財務報導」編製允當表達之合併財務報告係管理階層之責任，本會計師之責任係依據核閱結果對合併財務報告作成結論。

範圍

除保留結論之基礎段所述者外，本會計師係依照審計準則公報第六十五號「財務報表之核閱」執行核閱工作。核閱合併財務報告時所執行之程序包括查詢(主要向負責財務與會計事務之人員查詢)、分析性程序及其他核閱程序。核閱工作之範圍明顯小於查核工作之範圍，因此本會計師可能無法察覺所有可藉由查核工作辨認之重大事項，故無法表示查核意見。

保留結論之基礎

如合併財務報告附註四(二)所述，列入上開合併財務報告之部份非重要子公司，係依該等被投資公司同期間未經會計師核閱之財務報告為依據，民國一一一年及一一〇年六月三十日之資產總額分別為3,071,715千元及2,272,134千元，分別占合併資產總額之17.54%及14.80%；負債總額分別為647,183千元及465,678千元，分別占合併負債總額之8.10%及6.75%；民國一一一年及一一〇年四月一日至六月三十日及一一一年及一一〇年一月一日至六月三十日之綜合損益分別為137,251千元、69,653千元、283,126千元及104,071千元，分別占合併綜合損益之23.02%、29.61%、22.03%及21.03%。

保留結論

依本會計師核閱結果及其他會計師之核閱報告(請參閱其他事項段)，除保留結論之基礎段所述該等被投資公司財務報告倘經會計師核閱，對合併財務報告可能有所調整之影響外，並未發現上開合併財務報告在所有重大方面有未依照證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可並發布生效之國際會計準則第三十四號「期中財務報導」編製，致無法允當表達台灣半導體股份有限公司及其子公司民國一一一年及一一〇年六月三十日之合併財務狀況，與民國一一一年及一一〇年四月一日至六月三十日及一一一年及一一〇年一月一日至六月三十日之合併財務績效暨民國一一一年及一一〇年一月一日至六月三十日之合併現金流量之情事。

其他事項

列入上開合併財務報告之子公司中，有關鼎翰科技股份有限公司之財務報告未經本會計師核閱，而係由其他會計師核閱，因此，本會計師對上開合併財務報告之核閱結果，有關鼎翰科技股份有限公司之財務報告所列之金額係依據其他會計師之核閱報告。鼎翰科技股份有限公司於民國一一一年及一一〇年六月三十日之資產總額分別為7,053,307千元及6,640,736千元，分別占合併資產總額之40.27%及43.27%；於民國一一一年及一一〇年四月一日至六月三十日及一一一年及一一〇年一月一日至六月三十日之營業收入淨額分別為2,042,284千元、1,735,886千元、3,804,367千元及3,260,827千元，分別占合併營業收入淨額之51.51%、53.72%、49.30%及53.37%。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

梅元貞



許育峰



證券主管機關：金管證六字第0940100754號
核准簽證文號：台財證六字第0930105495號
民國一一一年八月十日

民國一十一年及一〇年六月三十日經核閱，未依一般公認審計準則查核
台灣半導體股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一十一年六月三十日、一〇年十二月三十一日及六月三十日

單位：新台幣千元

	111.6.30		110.12.31		110.6.30			111.6.30		110.12.31		110.6.30			
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%		
資 產															
流動資產：															
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 2,858,561	16	2,701,648	17	2,712,377	18	2100	短期借款(附註六(十一))	\$ 1,135,034	6	921,426	6	1,341,862	9
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註六(二))	232,342	1	155,067	1	3,473	-	2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動(附註六(二))	14,361	-	563	-	2,205	-
1150	應收票據淨額(附註六(三))	207	-	751	-	67	-	2150	應付票據	-	-	1,607	-	-	-
1170	應收帳款淨額(附註六(三))	3,369,004	19	2,950,815	19	2,727,956	18	2170	應付帳款	1,764,263	10	1,673,549	10	1,527,741	10
1200	其他應收款	73,129	1	63,284	-	47,907	-	2200	其他應付款(附註六(十三))	1,829,927	10	883,040	6	1,395,460	9
1220	本期所得稅資產	10,079	-	929	-	710	-	2230	本期所得稅負債	357,871	2	412,838	3	288,394	2
130X	存貨(附註六(四))	3,059,102	18	2,444,825	15	2,138,744	14	2322	一年內到期長期借款(附註六(十二))	109,775	1	65,000	-	4,000	-
1410	預付款項	208,169	1	177,271	1	192,749	1	2280	租賃負債—流動(附註六(十四))	96,366	1	113,331	1	97,787	1
1476	其他金融資產—流動(附註六(二))	523,802	3	373,584	2	431,245	3	2399	其他流動負債	299,486	2	232,681	1	189,759	1
		<u>10,334,395</u>	<u>59</u>	<u>8,868,174</u>	<u>55</u>	<u>8,255,228</u>	<u>54</u>			<u>5,607,083</u>	<u>32</u>	<u>4,304,035</u>	<u>27</u>	<u>4,847,208</u>	<u>32</u>
非流動資產：															
1600	不動產、廠房及設備(附註六(六))	4,473,543	26	4,501,135	28	4,425,274	29	2540	長期借款(附註六(十二))	1,329,555	8	1,484,310	10	1,057,280	7
1755	使用權資產(附註六(七))	247,387	1	280,665	2	324,430	2	2580	租賃負債—非流動(附註六(十四))	145,588	1	190,820	1	242,985	2
1822	無形資產(附註六(八))	354,071	2	388,016	3	438,124	3	2640	淨確定福利負債—非流動	42,578	-	42,788	-	44,976	-
1805	商譽(附註六(九))	1,099,926	6	1,024,426	6	1,031,088	7	2570	遞延所得稅負債	795,446	5	684,722	4	651,994	4
1840	遞延所得稅資產	457,753	3	456,197	3	461,569	3	2670	其他非流動負債	72,845	-	51,787	-	58,471	-
1980	其他金融資產—非流動(附註六(二))	79,790	-	71,583	-	67,377	-			<u>2,386,012</u>	<u>14</u>	<u>2,454,427</u>	<u>15</u>	<u>2,055,706</u>	<u>13</u>
1990	其他非流動資產(附註六(十))	466,913	3	395,775	3	344,798	2			<u>7,993,095</u>	<u>46</u>	<u>6,758,462</u>	<u>42</u>	<u>6,902,914</u>	<u>45</u>
		<u>7,179,383</u>	<u>41</u>	<u>7,117,797</u>	<u>45</u>	<u>7,092,660</u>	<u>46</u>								
負債及權益															
流動負債：															
非流動負債：															
負債總計															
歸屬母公司業主之權益：(附註六(十七))															
3110	普通股股本	2,634,854	15	2,650,854	17	2,650,854	17	3110	普通股股本	2,634,854	15	2,650,854	17	2,650,854	17
3200	資本公積	2,134,317	12	2,166,799	14	2,166,799	14	3200	資本公積	2,134,317	12	2,166,799	14	2,166,799	14
3300	保留盈餘	3,359,327	19	3,247,117	20	2,726,627	18	3300	保留盈餘	3,359,327	19	3,247,117	20	2,726,627	18
3400	其他權益	(387,947)	(2)	(531,125)	(4)	(542,503)	(4)	3400	其他權益	(387,947)	(2)	(531,125)	(4)	(542,503)	(4)
3500	庫藏股票	(506,043)	(3)	(506,990)	(3)	(506,990)	(3)	3500	庫藏股票	(506,043)	(3)	(506,990)	(3)	(506,990)	(3)
		<u>7,234,508</u>	<u>41</u>	<u>7,026,655</u>	<u>44</u>	<u>6,494,787</u>	<u>42</u>			<u>7,234,508</u>	<u>41</u>	<u>7,026,655</u>	<u>44</u>	<u>6,494,787</u>	<u>42</u>
36XX	非控制權益(附註六(五))	2,286,175	13	2,200,854	14	1,950,187	13	36XX	非控制權益(附註六(五))	2,286,175	13	2,200,854	14	1,950,187	13
		<u>9,520,683</u>	<u>54</u>	<u>9,227,509</u>	<u>58</u>	<u>8,444,974</u>	<u>55</u>			<u>9,520,683</u>	<u>54</u>	<u>9,227,509</u>	<u>58</u>	<u>8,444,974</u>	<u>55</u>
權益總計															
負債及權益總計															
		<u>\$ 17,513,778</u>	<u>100</u>	<u>15,985,971</u>	<u>100</u>	<u>15,347,888</u>	<u>100</u>			<u>\$ 17,513,778</u>	<u>100</u>	<u>15,985,971</u>	<u>100</u>	<u>15,347,888</u>	<u>100</u>
資產總計															

董事長：王秀亭



經理人：王秀亭

(請詳閱後附合併財務報告附註)



會計主管：鄭懿誠



僅經核閱，未依一般公認會計準則查核
台灣半導體股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一一年及一〇年四月一日至六月三十日及一〇年一月一日至六月三十日

單位：新台幣千元

	111年4月至6月		110年4月至6月		111年1月至6月		110年1月至6月	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
4110 銷貨收入(附註六(十九))	\$ 4,165,048	105	3,355,039	104	8,056,468	104	6,315,329	103
4190 減：銷貨退回及折讓	200,345	5	123,656	4	339,837	4	205,384	3
營業收入淨額	3,964,703	100	3,231,383	100	7,716,631	100	6,109,945	100
5000 營業成本(附註六(四))	2,567,843	65	2,217,108	69	5,089,574	66	4,199,618	69
營業毛利	1,396,860	35	1,014,275	31	2,627,057	34	1,910,327	31
6000 營業費用(附註六(十五)及(廿一))：								
6100 推銷費用	330,541	8	304,136	9	648,828	8	574,187	9
6200 管理費用	226,870	6	175,405	5	427,222	6	334,806	5
6300 研究發展費用	91,627	2	82,377	3	177,138	2	155,102	3
營業淨利	747,822	19	452,357	14	1,373,869	18	846,232	14
營業外收入及支出(附註六(二十))：								
7100 利息收入	3,522	-	4,025	-	6,850	-	7,199	-
7010 其他收入	14,933	-	18,787	-	26,915	-	35,050	-
7020 其他利益及損失	55,518	1	(6,101)	-	106,433	1	(4,250)	-
7050 財務成本	(8,630)	-	(6,972)	-	(15,709)	-	(17,013)	-
稅前淨利	813,165	20	462,096	14	1,498,358	19	867,218	14
7950 減：所得稅費用(附註六(十六))	238,455	6	147,211	4	438,649	5	259,462	4
本期淨利	574,710	14	314,885	10	1,059,709	14	607,756	10
8300 其他綜合損益：								
8360 後續可能重分類至損益之項目								
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	35,838	1	(90,093)	(3)	258,142	3	(124,544)	(2)
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	(14,243)	-	10,417	-	(32,432)	-	11,662	-
後續可能重分類至損益之項目合計	21,595	1	(79,676)	(3)	225,710	3	(112,882)	(2)
8300 本期其他綜合損益	21,595	1	(79,676)	(3)	225,710	3	(112,882)	(2)
本期綜合損益總額	\$ 596,305	15	235,209	7	1,285,419	17	494,874	8
本期淨利歸屬於：								
母公司業主	\$ 384,888	9	179,623	6	770,924	10	360,877	6
非控制權益(附註六(五))	189,822	5	135,262	4	288,785	4	246,879	4
	\$ 574,710	14	314,885	10	1,059,709	14	607,756	10
綜合損益總額歸屬於：								
母公司業主	\$ 370,238	9	126,458	4	914,102	12	277,674	4
非控制權益(附註六(五))	226,067	6	108,751	3	371,317	5	217,200	4
	\$ 596,305	15	235,209	7	1,285,419	17	494,874	8
基本每股盈餘(元)(附註六(廿二))	\$ 1.55		0.72		3.10		1.46	
稀釋每股盈餘(元)(附註六(廿二))	\$ 1.54		0.72		3.08		1.44	

董事長：王秀亭



(請詳閱後附合併財務報告附註)
經理人：王秀亭



會計主管：鄭懿誠



僅經核閱 本依 一般公認審計準則查核
台灣半導體股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一一年一月一日至六月三十日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

	股 本		資本公積	保留盈餘			合計	國外營運機構財務報表換算之兌換差 額		庫藏股票	歸屬於母公司業主權益總計	非控制權益	權益總額
	普通股股本	預收股本		法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘		差 額	庫藏股票				
民國一〇年一月一日餘額	\$ 2,494,539	22,196	1,516,265	830,920	445,618	1,484,440	2,760,978	(459,300)	(506,990)	5,827,688	2,020,901	7,848,589	
本期淨利	-	-	-	-	-	360,877	360,877	-	-	360,877	246,879	607,756	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	(83,203)	-	(83,203)	(29,679)	(112,882)	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	360,877	360,877	(83,203)	-	277,674	217,200	494,874	
可轉換公司債轉換	156,315	(22,196)	604,864	-	-	-	-	-	-	738,983	-	738,983	
盈餘指撥及分配：													
提列法定盈餘公積	-	-	-	53,967	-	(53,967)	-	-	-	-	-	-	
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	13,682	(13,682)	-	-	-	-	-	-	
現金股利	-	-	-	-	-	(395,228)	(395,228)	-	-	(395,228)	-	(395,228)	
發放子公司股利調整資本公積	-	-	20,400	-	-	-	-	-	-	20,400	-	20,400	
採用權益法認列之關聯企業變動數	-	-	25,270	-	-	-	-	-	-	25,270	-	25,270	
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(287,914)	(287,914)	
民國一〇年六月三十日餘額	\$ 2,650,854	-	2,166,799	884,887	459,300	1,382,440	2,726,627	(542,503)	(506,990)	6,494,787	1,950,187	8,444,974	
民國一一年一月一日餘額	\$ 2,650,854	-	2,166,799	884,887	459,300	1,902,930	3,247,117	(531,125)	(506,990)	7,026,655	2,200,854	9,227,509	
本期淨利	-	-	-	-	-	770,924	770,924	-	-	770,924	288,785	1,059,709	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	143,178	-	143,178	82,532	225,710	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	770,924	770,924	143,178	-	914,102	371,317	1,285,419	
庫藏股註銷	(16,000)	-	(69,482)	-	-	-	-	-	85,482	-	-	-	
子公司購入母公司之股票視為庫藏股票	-	-	-	-	-	-	-	-	(84,535)	(84,535)	-	(84,535)	
盈餘指撥及分配：													
提列法定盈餘公積	-	-	-	88,137	-	(88,137)	-	-	-	-	-	-	
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	71,825	(71,825)	-	-	-	-	-	-	
現金股利	-	-	-	-	-	(658,714)	(658,714)	-	-	(658,714)	-	(658,714)	
發放子公司股利調整資本公積	-	-	37,000	-	-	-	-	-	-	37,000	-	37,000	
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(285,996)	(285,996)	
民國一一年六月三十日餘額	\$ 2,634,854	-	2,134,317	973,024	531,125	1,855,178	3,359,327	(387,947)	(506,043)	7,234,508	2,286,175	9,520,683	

董事長：王秀亭



經理人：王秀亭



(請詳閱後附合併財務報告附註)

~6~

會計主管：鄭懿誠



僅經核閱，未依一般公認會計準則查核
台灣半導體股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一十一年及一〇年一月一日至六月三十日

單位：新台幣千元

	111年1月至6月	110年1月至6月
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 1,498,358	867,218
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	389,024	363,705
攤銷費用	67,627	60,853
預期信用減損損失	2,323	1,037
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	32,322	(1,296)
利息費用	14,651	16,030
利息收入	(6,850)	(7,199)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(857)	609
處分投資利益	-	(232)
非金融資產減損損失（迴轉利益）	(546)	2,707
其他	-	25,270
收益費損項目合計	497,694	461,484
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(95,799)	2,120
應收票據減少	544	119
應收帳款增加	(420,512)	(360,242)
其他應收款（增加）減少	(8,013)	27
存貨增加	(614,277)	(338,297)
預付款項增加	(41,205)	(37,458)
其他金融資產（增加）減少	(150,218)	50,575
應付票據減少	(1,607)	(1,652)
應付帳款增加	90,714	356,307
其他應付款增加	27,722	386,466
其他流動負債增加	66,747	51,372
淨確定福利負債減少	(210)	(271)
其他非流動負債增加	18,077	11,995
調整項目合計	(630,343)	582,545
營運產生之現金流入	868,015	1,449,763
收取之利息	5,018	7,171
支付之利息	(9,591)	(9,038)
支付之所得稅	(393,598)	(265,145)
營業活動之淨現金流入	469,844	1,182,751
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(211,472)	(150,143)
處分不動產、廠房及設備	4,372	897
其他金融資產（增加）減少	(8,207)	227
取得無形資產	(16,852)	(27,939)
其他非流動資產增加	(9,727)	(25,362)
預付設備款增加	(97,479)	(94,866)
投資活動之淨現金流出	(339,365)	(297,186)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加（減少）	213,608	(60,092)
償還可轉換公司債	-	(41,900)
舉借長期借款	90,020	91,730
償還長期借款	(200,000)	(330,000)
存入保證金增加（減少）	180	(42)
租賃本金償還	(78,893)	(42,046)
庫藏股票買回成本	(84,535)	-
非控制權益淨變動	11,265	(287,914)
籌資活動之淨現金流出	(48,355)	(670,264)
匯率變動對現金及約當現金之影響	74,789	(66,594)
本期現金及約當現金增加數	156,913	148,707
期初現金及約當現金餘額	2,701,648	2,563,670
期末現金及約當現金餘額	\$ 2,858,561	2,712,377

董事長：王秀亭



(請詳閱後附合併財務報告附註)
經理人：王秀亭



會計主管：鄭懿誠



僅經核閱，未依一般公認審計準則查核
台灣半導體股份有限公司及子公司
合併財務報告附註
民國一一年及一〇年第二季
(除另有註明者外，所有金額均以新台幣千元為單位)

一、公司沿革

台灣半導體股份有限公司(以下稱「本公司」)於民國六十八年一月依中華民國公司法設立，註冊地址為新北市新店區北新路3段205號11樓。本公司股票於民國八十九年二月在中華民國證券櫃檯買賣中心(以下稱「櫃買中心」)掛牌交易。

本公司為透過業務及組織重組，朝向專業分工，以提升企業經營效率及產業競爭力，將條碼印表機事業處以新設分割方式，分割予新設之鼎翰科技股份有限公司(以下稱「鼎翰科技」)；經董事會決議訂定分割基準日為民國九十六年八月一日。

本公司及子公司(以下併稱「合併公司」)主要營業項目為整流器及條碼印表機之製造及買賣業務。

二、通過財務報告之日期及程序

本合併財務報告已於民國一一年八月十日經董事會通過發布。

三、新發布及修訂準則及解釋之適用

(一)已採用金融監督管理委員會認可之新發布及修訂後準則及解釋之影響

合併公司自民國一一年一月一日起開始適用下列新修正之國際財務報導準則，且對合併財務報告未造成重大影響。

- 國際會計準則第16號之修正「不動產、廠房及設備－達到預定使用狀態前之價款」
- 國際會計準則第37號之修正「虧損性合約－履行合約之成本」
- 國際財務報導準則2018-2020週期之年度改善
- 國際財務報導準則第3號之修正「對觀念架構之引述」

(二)尚未採用金管會認可之國際財務報導準則之影響

合併公司評估適用下列自民國一二年一月一日起生效之新修正之國際財務報導準則，將不致對合併財務報告造成重大影響。

- 國際會計準則第1號之修正「會計政策之揭露」
- 國際會計準則第8號之修正「會計估計值之定義」
- 國際會計準則第12號之修正「與單一交易所產生之資產及負債有關之遞延所得稅」

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(三)金管會尚未認可之新發布及修訂準則及解釋

合併公司預期下列尚未認可之新發布及修正準則不致對合併財務報告造成重大影響。

- 國際財務報導準則第10號及國際會計準則第28號之修正「投資者與其關聯企業或合資間之資產出售或投入」
- 國際財務報導準則第17號「保險合約」及國際財務報導準則第17號之修正
- 國際會計準則第1號之修正「將負債分類為流動或非流動」
- 國際財務報導準則第17號之修正「初次適用IFRS 17及IFRS 9比較資訊」

四、重大會計政策之彙總說明

(一)遵循聲明

本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則(以下稱「編製準則」)及金管會認可並發布生效之國際會計準則第三十四號「期中財務報導」編製。本合併財務報告未包括依照金管會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(以下稱「金管會認可之國際財務報導準則」)所編製之整份年度合併財務報告應揭露之全部必要資訊。

本合併財務報告所採用之重大會計政策與民國一一〇年度合併財務報告相同，相關資訊請參閱民國一一〇年度合併財務報告。

(二)合併基礎

1.列入本合併財務報告之子公司包含：

投資公司名稱	子公司名稱	業務性質	所持股權百分比		
			111.6.30	110.12.31	110.6.30
本公司	Ever Energetic Int'l Ltd. (Ever Energetic)	對各種生產事業之投資及一般進出口業務	100.00 %	100.00 %	100.00 %
本公司	Ever Winner Int'l Co., Ltd. (Ever Winner)	對各種生產事業之投資及一般進出口業務	100.00 %	100.00 %	100.00 %
本公司	Skyrise Int'l Ltd. (Skyrise)	對各種生產事業之投資及一般進出口業務	100.00 %	100.00 %	100.00 %
本公司	Taiwan Semiconductor Europe GmbH (TSCE)	一般進出口業務	100.00 %	100.00 %	100.00 %
本公司	Taiwan Semiconductor Japan Ltd. (TSCJ)	整流器之買賣業務	100.00 %	100.00 %	100.00 %
本公司	Taiwan Semiconductor (H.K.) Co., Ltd. (TSCH)	對各種生產事業之投資及整流器之買賣業務	25.22 %	25.22 %	25.22 %
本公司	鼎翰科技	條碼印表機之製造及買賣業務	36.38 %	36.38 %	36.38 %
Ever Energetic	TSCH	對各種生產事業之投資及整流器之買賣業務	36.96 %	36.96 %	36.96 %
Ever Energetic	TSC America, Inc.(TSCA)	整流器之買賣業務	75.00 %	75.00 %	75.00 %
Ever Winner	TSCH	對各種生產事業之投資及整流器之買賣業務	37.82 %	37.82 %	37.82 %
Ever Winner	TSCA	整流器之買賣業務	25.00 %	25.00 %	25.00 %
Ever Winner	上海瀚科國際貿易有限公司(上海瀚科)	整流器之買賣業務	100.00 %	100.00 %	100.00 %

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

投資公司名稱	子公司名稱	業務性質	所持股權百分比		
			111.6.30	110.12.31	110.6.30
TSCH	陽信長威電子有限公司(陽信長威)	整流器之製造及買賣業務	100.00 %	100.00 %	100.00 %
TSCH	天津長威科技有限公司(天津長威)	晶片之製造及買賣業務	100.00 %	100.00 %	100.00 %
鼎翰科技	TSC Auto ID Technology EMEA GmbH (TSCAE)	條碼印表機及其零件之買賣	100.00 %	100.00 %	100.00 %
鼎翰科技	TSC Auto ID (H.K.) Ltd. (TSC HK)	各種生產事業之投資及一般進出口業務	100.00 %	100.00 %	100.00 %
鼎翰科技	TSC Auto Technology America Inc. (TSCAA)	條碼印表機及其零件之買賣	100.00 %	100.00 %	100.00 %
鼎翰科技	鼎貫科技股份有限公司(鼎貫科技)	條碼印表機及其零件之買賣	100.00 %	100.00 %	100.00 %
鼎翰科技及TSCAA	Printronic Auto ID Technology Inc. (PTNX US)	條碼印表機及其零件之買賣	100.00 %	100.00 %	100.00 %
鼎翰科技	Diversified Labeling Solutions, Inc. (DLS)	印表機耗材及各式標籤紙之客製化設計、整合及產銷	100.00 %	100.00 %	100.00 %
鼎翰科技	TSC Auto ID Technology India Private limited (TSCIN)	條碼印表機及其零件之買賣	100.00 %	100.00 %	-
TSCAE	TSC Auto ID Technology ME, Ltd. FZE (TSCAD)	條碼印表機及其零件之買賣	100.00 %	100.00 %	100.00 %
TSCAE	TSC Auto ID Technology Spain, S.L. (TSCAS)	條碼印表機及其零件之買賣	100.00 %	100.00 %	100.00 %
TSC HK	天津國聚科技有限公司(天津國聚)	條碼印表機及其零件之產銷	100.00 %	100.00 %	100.00 %
TSC HK	深圳鼎貫科技有限公司(深圳鼎貫)	條碼印表機及其零件之買賣	100.00 %	100.00 %	100.00 %
DLS	Precision Press & Label, Inc. (PPL)	印表機各式標籤紙及其耗材之銷售	100.00 %	100.00 %	100.00 %

2.未列入合併財務報告之子公司：無。

3.為簡化集團組織架構及增進營運效率，經鼎翰科技董事會於民國一十一年六月二十八日決議，將鼎翰科技持有美國孫公司PTNX US之5%股權移轉予美國子公司TSCAA，轉讓對價暫定為美金162萬元，股份轉讓完成後，TSCAA將吸收合併持股100%之子公司PTNX US，並以民國一十一年七月一日為合併基準日。

(三)所得稅

合併公司係依國際會計準則公報第34號「期中財務報導」第B12段規定衡量及揭露期中期間之所得稅費用。

所得稅費用係以期中報導期間之稅前淨利乘以管理階層對於全年度預計有效稅率之最佳估計衡量，並依預計全年度當期所得稅費用及遞延所得稅費用之比例分攤為當期所得稅費用及遞延所得稅費用。

所得稅費用係直接認列於權益項目或其他綜合損益項目者，係就相關資產及負債於財務報導目的之帳面金額與其課稅基礎之暫時性差異，以預期實現或清償時之適用稅率予以衡量。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(四)員工福利

期中期間之確定福利計畫退休金係採用前一年度報導期間結束日(以下稱報導日)依精算決定退休金成本率，以年初至當期期末為基礎計算，並針對該報導日後之重大市場波動，及重大縮減、清償或其他重大一次性事項加以調整。

五、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源

管理階層依編製準則及金管會認可之國際會計準則第34號「期中財務報導」編製本合併財務報告時，必須作出判斷、估計及假設，其將對會計政策之採用及資產、負債、收益及費損之報導金額有所影響。實際結果可能與估計存有差異。

編製合併財務報告時，管理階層於採用合併公司會計政策時所作之重大判斷以及估計不確定性之主要來源與民國一一〇年度合併財務報告一致。

六、重要會計項目之說明

除下列所述外，本合併財務報告重要會計項目之說明與民國一一〇年度合併財務報告尚無重大差異，相關資訊請參閱民國一一〇年度合併財務報告。

(一)現金及約當現金

	111.6.30	110.12.31	110.6.30
現金及零用金	\$ 628	535	621
支票及活期存款	2,795,328	2,209,699	2,471,739
定期存款	62,605	491,414	240,017
	\$ 2,858,561	2,701,648	2,712,377

合併公司金融資產及負債之利率風險及敏感度分析之揭露請詳附註六(廿三)。

(二)金融資產及負債

1.明細如下：

	111.6.30	110.12.31	110.6.30
流 動：			
強制透過損益按公允價值衡量			
之金融資產：			
受益憑證	\$ 230,267	150,032	-
遠期外匯合約	1,662	3,458	3,473
換匯交易	413	1,577	-
	\$ 232,342	155,067	3,473
其他金融資產：			
結構性定期存款	\$ 523,802	373,584	431,245

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

	<u>111.6.30</u>	<u>110.12.31</u>	<u>110.6.30</u>
非流動：			
其他金融資產：			
存出保證金	\$ <u>79,790</u>	<u>71,583</u>	<u>67,377</u>
流動：			
強制透過損益按公允價值衡量			
之金融負債：			
遠期外匯合約	\$ 5,508	234	1,622
換匯交易	<u>8,853</u>	<u>329</u>	<u>583</u>
	<u>\$ 14,361</u>	<u>563</u>	<u>2,205</u>

合併公司已於附註六(廿三)揭露與金融工具相關之信用、貨幣及利率暴險。

- 2.從事衍生金融工具係因以規避營業活動所暴露之匯率風險，合併公司因未適用避險會計列報為強制透過損益按公允價值衡量之金融資產及持有供交易之金融負債之衍生工具明細如下：

111.6.30						
		<u>合約金額</u>			<u>到期期間</u>	
				<u>幣別</u>		
賣出/買入遠期外匯	USD	5,000 / CNY	32,585	美元兌人民幣	111.07~111.09	
賣出/買入遠期外匯	EUR	3,000 / NTD	94,631	歐元兌台幣	111.07~111.08	
賣出/買入遠期外匯	USD	4,000 / NTD	117,607	美元兌台幣	111.07~111.08	
換匯交易	USD	10,500 / NTD	302,782	美元兌台幣	111.08~111.11	
110.12.31						
		<u>合約金額</u>			<u>到期期間</u>	
				<u>幣別</u>		
賣出/買入遠期外匯	USD	6,000 / CNY	38,720	美元兌人民幣	111.01~111.02	
賣出/買入遠期外匯	EUR	5,000 / NTD	157,122	歐元兌台幣	111.01~111.02	
賣出/買入遠期外匯	USD	12,000 / NTD	333,179	美元兌台幣	111.01~111.04	
換匯交易	USD	7,000 / NTD	195,410	美元兌台幣	111.01~111.03	
換匯交易	NTD	83,394 / USD	3,000	台幣兌美元	111.01.20	
110.6.30						
		<u>合約金額</u>			<u>到期期間</u>	
				<u>幣別</u>		
賣出/買入遠期外匯	USD	12,000 / CNY	78,130	美元兌人民幣	110.07~110.10	
賣出/買入遠期外匯	EUR	1,200 / USD	1,455	歐元兌美元	110.07~110.09	
賣出/買入遠期外匯	EUR	1,000 / NTD	33,766	歐元兌台幣	110.08.20	
賣出/買入遠期外匯	EUR	3,000 / USD	3,567	歐元兌美元	110.07~110.08	
賣出/買入遠期外匯	USD	4,000 / NTD	111,045	美元兌台幣	110.07~110.08	
換匯交易	USD	3,000 / NTD	83,022	美元兌台幣	110.08.16	

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(三)應收票據及應收帳款

	<u>111.6.30</u>	<u>110.12.31</u>	<u>110.6.30</u>
應收票據	\$ 207	751	67
應收帳款	3,411,641	2,990,245	2,759,180
減：備抵損失	(42,637)	(39,430)	(31,224)
	<u>\$ 3,369,211</u>	<u>2,951,566</u>	<u>2,728,023</u>

合併公司針對所有應收票據及應收帳款採用簡化作法估計預期信用損失，亦即使用存續期間預期信用損失衡量，為此衡量目的，該等應收票據及應收帳款係按代表客戶依據合約條款支付所有到期金額能力之共同信用風險特性予以分組，並已納入前瞻性之資訊。

合併公司整流器部門應收票據及應收帳款之預期信用損失分析如下：

	<u>111.6.30</u>		
	<u>應收款項 帳面金額</u>	<u>加權平均預期 信用損失率</u>	<u>備抵存續期間 預期信用損失</u>
未逾期	\$ 1,814,608	0.95%	17,182
逾期1~90天	166,255	0.98%	1,633
逾期91~180天	2,153	3.00%	65
逾期181~270天	302	5.00%	15
逾期271~365天	20	10.00%	2
	<u>\$ 1,983,338</u>		<u>18,897</u>
	<u>110.12.31</u>		
	<u>應收款項 帳面金額</u>	<u>加權平均預期 信用損失率</u>	<u>備抵存續期間 預期信用損失</u>
未逾期	\$ 1,620,596	0.90%	14,656
逾期1~90天	73,698	1.05%	787
逾期91~180天	2,070	3.00%	62
逾期181~270天	536	5.00%	27
逾期271~365天	145	10.00%	14
	<u>\$ 1,697,045</u>		<u>15,546</u>
	<u>110.6.30</u>		
	<u>應收款項 帳面金額</u>	<u>加權平均預期 信用損失率</u>	<u>備抵存續期間 預期信用損失</u>
未逾期	\$ 1,357,834	1.08%	14,710
逾期1~90天	69,310	1.03%	712
逾期91~180天	1,235	3.00%	37
逾期181~270天	63	5.00%	3
	<u>\$ 1,428,442</u>		<u>15,462</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

合併公司條碼列印機部門應收票據及應收帳款之預期信用損失分析如下：

111.6.30			
	應收款項 帳面金額	加權平均預期 信用損失率	備抵存續期間 預期信用損失
未逾期	\$ 1,040,366	0.74%	7,723
逾期1~90天	314,669	1.00%	3,147
逾期91~180天	34,454	3.00%	1,034
逾期181~270天	23,657	5.00%	1,183
逾期271~365天	5,234	10.00%	523
逾期365天以上	10,130	100.00%	10,130
合計	<u>\$ 1,428,510</u>		<u>23,740</u>

110.12.31			
	應收款項 帳面金額	加權平均預期 信用損失率	備抵存續期間 預期信用損失
未逾期	\$ 907,787	1.27%	11,574
逾期1~90天	321,569	1.00%	3,216
逾期91~180天	43,043	3.00%	1,291
逾期181~270天	6,954	5.00%	348
逾期271~365天	7,937	10.00%	794
逾期365天以上	6,661	100.00%	6,661
合計	<u>\$ 1,293,951</u>		<u>23,884</u>

110.6.30			
	應收款項 帳面金額	加權平均預期 信用損失率	備抵存續期間 預期信用損失
未逾期	\$ 959,598	0.26%	2,467
逾期1~90天	341,298	1.00%	3,413
逾期91~180天	18,567	3.00%	557
逾期181~270天	1,390	5.00%	70
逾期271~365天	774	10.00%	77
逾期365天以上	9,178	100.00%	9,178
合計	<u>\$ 1,330,805</u>		<u>15,762</u>

合併公司應收票據及應收帳款之備抵損失變動表如下：

	111年1月至6月	110年1月至6月
期初餘額	\$ 39,430	30,564
本期認列	2,323	1,037
外幣換算損益	884	(377)
期末餘額	<u>\$ 42,637</u>	<u>31,224</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

截至民國一一年六月三十日、一〇年十二月三十一日及六月三十日止，合併公司應收票據及應收帳款均未貼現或作為擔保品。

(四)存 貨

	<u>111.6.30</u>	<u>110.12.31</u>	<u>110.6.30</u>
製成品	\$ 1,461,992	1,077,222	884,792
減：備抵損失	<u>(133,334)</u>	<u>(138,978)</u>	<u>(63,306)</u>
	<u>1,328,658</u>	<u>938,244</u>	<u>821,486</u>
半成品及在製品	678,596	513,459	468,173
減：備抵損失	<u>(58,982)</u>	<u>(51,076)</u>	<u>(66,875)</u>
	<u>619,614</u>	<u>462,383</u>	<u>401,298</u>
原物料	1,013,495	926,460	850,863
減：備抵損失	<u>(39,801)</u>	<u>(31,811)</u>	<u>(32,417)</u>
	<u>973,694</u>	<u>894,649</u>	<u>818,446</u>
在途存貨	<u>137,136</u>	<u>149,549</u>	<u>97,514</u>
	<u>\$ 3,059,102</u>	<u>2,444,825</u>	<u>2,138,744</u>

合併公司民國一一年及一〇年四月一日至六月三十日及一一年及一〇年一月一日至六月三十日認列為銷貨成本及費用之存貨成本分別為2,591,774千元、2,210,176千元、5,085,296千元及4,168,479千元。民國一一年及一〇年四月一日至六月三十日及一一年及一〇年一月一日至六月三十日因存貨自成本沖減至淨變現價值而認列之營業成本分別為(23,931)千元、6,932千元、4,278千元及31,139千元。

截至民國一一年六月三十日、一〇年十二月三十一日及六月三十日止，合併公司之存貨均未有提供作質押擔保之情形。

(五)具重大非控制權益之子公司

子公司之非控制權益對合併公司具重大性者如下：

子公司名稱	公司註冊 之 國 家	非控制權益之所有權 權益及表決權之比例		
		<u>111.6.30</u>	<u>110.12.31</u>	<u>110.6.30</u>
鼎翰科技	台灣	63.62 %	63.62 %	63.62 %

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

上述子公司之彙總性財務資訊如下，該等財務資訊係依據金管會認可之國際財務報導準則所編製，該等財務資訊係合併公司間之交易尚未銷除前之金額：

彙總性財務資訊：

	<u>111.6.30</u>	<u>110.12.31</u>	<u>110.6.30</u>
流動資產	\$ 4,119,807	3,696,285	3,691,582
非流動資產	4,025,948	3,973,806	3,885,387
流動負債	(2,762,055)	(2,200,537)	(2,751,862)
非流動負債	(1,269,103)	(1,381,411)	(1,283,026)
淨資產	<u>\$ 4,114,597</u>	<u>4,088,143</u>	<u>3,542,081</u>
非控制權益期末帳面金額	<u>\$ 2,286,175</u>	<u>2,200,854</u>	<u>1,950,187</u>
	<u>111年4月至6月</u>	<u>110年4月至6月</u>	<u>111年1月至6月</u>
營業收入	\$ <u>2,042,284</u>	<u>1,735,886</u>	<u>3,804,375</u>
本期淨利	\$ 298,368	212,609	453,922
其他綜合損益	(170,907)	86,169	28,511
綜合損益總額	<u>\$ 127,461</u>	<u>298,778</u>	<u>482,433</u>
歸屬於非控制權益			
之本期淨利	<u>\$ 189,822</u>	<u>135,262</u>	<u>288,785</u>
歸屬於非控制權益			
之綜合損益總額	<u>\$ 226,067</u>	<u>108,751</u>	<u>371,317</u>
營業活動現金流量		\$ 25,550	342,418
投資活動現金流量		(153,797)	(95,616)
籌資活動現金流量		(59,499)	(286,507)
匯率變動對現金及 約當現金之影響		25,611	(11,616)
現金及約當現金淨 減少數		<u>\$ (162,135)</u>	<u>(51,321)</u>

(六)不動產、廠房及設備

	<u>土 地</u>	<u>房 屋 及 建 築</u>	<u>機 器 及 其 他 設 備</u>	<u>總 計</u>
帳面金額：				
民國111年1月1日	\$ <u>861,426</u>	<u>940,531</u>	<u>2,699,178</u>	<u>4,501,135</u>
民國111年6月30日	\$ <u>861,426</u>	<u>929,285</u>	<u>2,682,832</u>	<u>4,473,543</u>
民國110年1月1日	\$ <u>861,426</u>	<u>986,300</u>	<u>2,715,160</u>	<u>4,562,886</u>
民國110年6月30日	\$ <u>861,426</u>	<u>959,536</u>	<u>2,604,312</u>	<u>4,425,274</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

- 1.截至民國一一一年六月三十日、一一〇年十二月三十一日及六月三十日止合併公司之不動產、廠房及設備均未有提供作質押之情形。
- 2.本公司民國一一一年及一一〇年四月一日至六月三十日及一一一年及一一〇年一月一日至六月三十日購置固定資產利息費用資本化金額分別為72千元、266千元、290千元及848千元，資本化利率分別為1.50%及3.00%。

(七)使用權資產

	<u>土地使用權</u>	<u>房屋及建築</u>	<u>運輸設備</u>	<u>總計</u>
帳面金額：				
民國111年1月1日	\$ <u>8,814</u>	<u>266,977</u>	<u>4,874</u>	<u>280,665</u>
民國111年6月30日	\$ <u>8,826</u>	<u>233,868</u>	<u>4,693</u>	<u>247,387</u>
民國110年1月1日	\$ <u>9,238</u>	<u>288,214</u>	<u>6,509</u>	<u>303,961</u>
民國110年6月30日	\$ <u>8,918</u>	<u>308,997</u>	<u>6,515</u>	<u>324,430</u>

(八)無形資產

	<u>專門技術</u>	<u>顧客關係</u>	<u>專利權</u>	<u>電腦軟體</u>	<u>商標權</u>	<u>合計</u>
帳面金額：						
民國111年1月1日	\$ <u>54,265</u>	<u>190,632</u>	<u>12,652</u>	<u>130,467</u>	-	<u>388,016</u>
民國111年6月30日	\$ <u>50,022</u>	<u>179,917</u>	<u>9,489</u>	<u>114,643</u>	-	<u>354,071</u>
民國110年1月1日	\$ <u>71,349</u>	<u>243,605</u>	<u>18,978</u>	<u>142,762</u>	-	<u>476,694</u>
民國110年6月30日	\$ <u>62,252</u>	<u>215,087</u>	<u>15,815</u>	<u>144,970</u>	-	<u>438,124</u>

(九)商譽

	<u>111.6.30</u>	<u>110.12.31</u>	<u>110.6.30</u>
成 本			
期初餘額	\$ 1,024,426	1,054,034	1,054,034
匯率變動之影響	<u>75,500</u>	<u>(29,608)</u>	<u>(22,946)</u>
期末餘額	<u>\$ 1,099,926</u>	<u>1,024,426</u>	<u>1,031,088</u>

合併公司已分攤商譽至整流器部門之現金產生單位及條碼列印機部門之現金產生單位，商譽總帳面金額之分攤列示如下：

	<u>111.6.30</u>	<u>110.12.31</u>	<u>110.6.30</u>
整流器部門現金產生單位	\$ 75,965	70,750	71,210
條碼列印機部門現金產生單位	<u>1,023,961</u>	<u>953,676</u>	<u>959,878</u>
	<u>\$ 1,099,926</u>	<u>1,024,426</u>	<u>1,031,088</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(十)其他非流動資產

	<u>111.6.30</u>	<u>110.12.31</u>	<u>110.6.30</u>
預付設備款	\$ 251,717	190,305	159,812
其他	215,196	205,470	184,986
	<u>\$ 466,913</u>	<u>395,775</u>	<u>344,798</u>

(十一)短期借款

	<u>111.6.30</u>	<u>110.12.31</u>	<u>110.6.30</u>
信用借款	\$ 1,075,594	810,706	1,286,142
進口借款	59,440	110,720	55,720
	<u>\$ 1,135,034</u>	<u>921,426</u>	<u>1,341,862</u>
尚未使用額度	<u>\$ 4,616,103</u>	<u>4,482,773</u>	<u>4,294,918</u>
利率區間(%)	<u>0.44%~2.49%</u>	<u>0.46%~1.02%</u>	<u>0.42%~1.05%</u>

有關合併公司利率、外幣及流動性風險之暴險資訊，請詳附註六(廿三)。

合併公司提供擔保品情形，請詳附註九。

(十二)長期借款

	<u>111.6.30</u>		
	<u>利率區間</u>	<u>到期年度</u>	<u>金額</u>
無擔保銀行借款	0.825%	116.07.16	\$ 256,000
	0.825%	115.12.04	62,830
	0.825%	114.03.28	158,500
	0.825%	113.12.25	220,100
	1.00%	113.03.08	41,900
	1.25%~1.27%	113.07.22	700,000
			1,439,330
減：一年內到期部分			(109,775)
合計			<u>\$ 1,329,555</u>
尚未使用額度			<u>\$ 1,660,670</u>
			<u>1,549,310</u>
			(65,000)
合計			<u>\$ 1,484,310</u>
尚未使用額度			<u>\$ 1,950,690</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

	110.6.30		
	利率區間	到期年度	金額
無擔保銀行借款	0.45%	116.07.16	\$ 23,100
	0.45%	115.12.04	62,830
	0.45%	114.03.28	55,700
	0.45%	113.12.25	177,750
	1.00%	113.03.08	41,900
	0.93%~1.00%	112.09.23	700,000
			\$ 1,061,280
減：一年內到期部分			(4,000)
合計			<u>\$ 1,057,280</u>
尚未使用額度			<u>\$ 2,038,720</u>

1.鼎翰科技為充實中期營運資金，分別與各家銀行簽訂授信合約，並定期支付利息，短期借款於合約到期前，可於融資額度內循環動用；中長期借款不得循環動用。上述借款到期日皆係以借款期間之訖日為揭露基準。與元大商業銀行額外約定，有關鼎翰科技年度及半年度合併財務報告之財務比率承諾如下：

- (1)流動比率不得低於110%；負債／有形淨值比率不得高於300%；
- (2)有形淨值應維持在新台幣12億元以上。
- (3)償債準備比率不得低於1倍。

2.本公司於民國一一一年及一一〇年一月一日至六月三十日向金融機構新增無擔保借款分別為90,020千元及91,730千元，依合約規定還本寬限期為3~5年。

有關合併公司利率、外幣及流動性風險之暴險資訊，請詳附註六(廿三)。

合併公司提供擔保品情形，請詳附註九。

(十三)其他應付款

	111.6.30	110.12.31	110.6.30
應付薪資及獎金	\$ 466,759	452,277	364,033
應付現金股利(含鼎翰科技)	918,975	-	645,074
應付設備款	106,932	108,104	105,459
其他	337,261	322,659	280,894
	<u>\$ 1,829,927</u>	<u>883,040</u>	<u>1,395,460</u>

(十四)租賃負債

合併公司租賃負債之帳面金額如下：

	111.6.30	110.12.31	110.6.30
流動	\$ 96,366	113,331	97,787
非流動	145,588	190,820	242,985
	<u>\$ 241,954</u>	<u>304,151</u>	<u>340,772</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

到期分析請詳附註六(廿三)金融工具。

租賃認列於損益之金額如下：

	<u>111年4月至6月</u>	<u>110年4月至6月</u>	<u>111年1月至6月</u>	<u>110年1月至6月</u>
租賃負債之利息費用	\$ <u>2,527</u>	<u>2,801</u>	<u>5,159</u>	<u>5,865</u>
短期租賃之費用	\$ <u>1,903</u>	<u>2,271</u>	<u>4,027</u>	<u>4,530</u>
低價值租賃資產之費用(不包含短期租賃之低價值租賃)	\$ <u>1,169</u>	<u>1,684</u>	<u>5,562</u>	<u>3,997</u>

合併公司承租若干建築物及運輸設備做為辦公室、廠房及公務車使用，租賃期間為1~6年。位於美國之辦公室及倉庫租賃約定每年依3%費率調增租賃給付。

認列於現金流量表之金額如下：

	<u>111年1月至6月</u>	<u>110年1月至6月</u>
租賃之現金流出總額	\$ <u>93,641</u>	<u>56,438</u>

(十五)員工福利

1.確定福利計畫

因前一年度報導日後未發生重大市場波動、及重大縮減、清償或其他重大一次性事項，故合併公司採用民國一一〇年及一〇九年十二月三十一日精算決定之退休金成本衡量及揭露期中期間之退休金成本。

合併公司列報為費用之明細如下：

	<u>111年4月至6月</u>	<u>110年4月至6月</u>	<u>111年1月至6月</u>	<u>110年1月至6月</u>
營業成本	\$ 80	134	167	266
推銷費用	22	38	45	75
管理費用	60	30	119	64
研究發展費用	17	24	33	47
	\$ <u>179</u>	<u>226</u>	<u>364</u>	<u>452</u>

2.確定提撥計畫

合併公司民國一一一年及一一〇年四月一日至六月三十日及一一一年及一一〇年一月一日至六月三十日確定提撥退休金辦法下之退休金費用分別為16,371千元、13,695千元、31,900千元及26,755千元，已提撥至勞工保險局。

3.海外子公司則依當地法律適用確定提撥退休辦法，民國一一一年及一一〇年四月一日至六月三十日及一一一年及一一〇年一月一日至六月三十日認列之退休金費用各為12,613千元、11,034千元、25,719千元及22,222千元。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(十六)所得稅

1.合併公司所得稅費用如下：

	<u>111年4月至6月</u>	<u>110年4月至6月</u>	<u>111年1月至6月</u>	<u>110年1月至6月</u>
當期所得稅費用				
當期產生	\$ 190,755	118,036	358,028	216,083
未分配盈餘加				
徵稅額	15,051	14,873	15,051	14,873
調整前期之當				
期所得稅	<u>(7,280)</u>	<u>(1,285)</u>	<u>(7,263)</u>	<u>(1,398)</u>
	<u>198,526</u>	<u>131,624</u>	<u>365,816</u>	<u>229,558</u>
遞延所得稅費用				
暫時性差異之				
發生	<u>39,929</u>	<u>15,587</u>	<u>72,833</u>	<u>29,904</u>
所得稅費用	<u>\$ 238,455</u>	<u>147,211</u>	<u>438,649</u>	<u>259,462</u>

2.合併公司認列於其他綜合損益之下的所得稅費用(利益)明細如下：

	<u>111年4月至6月</u>	<u>110年4月至6月</u>	<u>111年1月至6月</u>	<u>110年1月至6月</u>
後續可能重分類至				
損益之項目：				
國外營運機構財				
務報表換算之				
兌換差額	<u>\$ 14,243</u>	<u>(10,417)</u>	<u>32,432</u>	<u>(11,662)</u>

3.合併公司民國一一一年及一一〇年一月一日至六月三十日並無認列於權益之所得稅費用。

4.截至民國一一一年六月三十日止，本公司及鼎翰科技之營利事業所得稅結算申報，業經稅捐稽徵機關分別核定至民國一〇八年度及民國一〇九年度。

5.本公司部份投資國外子公司之盈餘，因國外營運擴充資金所需，長期暫不擬匯回，故依國際會計準則公報第12號「所得稅」A39段規定，將此盈餘財稅差異視為永久性差異處理。

(十七)權益

1.股本

本公司於民國一一一年一月十日經董事會決議，註銷庫藏股票1,600千股並消除資本公積-庫藏股票交易69,482千元，以民國一一一年一月十日為減資基準日，業已完成法定變更程序。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

本公司於民國一一〇年因可轉換公司債持有人行使轉換數而發行新股13,412千股，每股面額10元，其行使價格超過普通股之溢價分別為604,864千元，列於資本公積—可轉換公司債轉換溢價項下，以民國一一〇年三月二十六日為發行新股暨增資基準日，相關法定變更程序已辦理完竣。

本公司民國一一一年六月三十日、一一〇年十二月三十一日及六月三十日額定股本皆為3,600,000千元(其中100,000千元係留供發行員工認股權憑證使用)，實收股本分別為2,634,854千元、2,650,854千元及2,650,854千元，每股面額均為10元。

2.資本公積

	<u>111.6.30</u>	<u>110.12.31</u>	<u>110.6.30</u>
股票發行溢價	\$ 639,859	639,859	639,859
可轉換公司債轉換溢價	1,229,442	1,229,442	1,229,442
庫藏股票交易	140,945	173,427	173,427
員工認股權發行溢價	24,378	24,378	24,378
轉換公司債應付利息補償金	18,674	18,674	18,674
員工認股權	1,543	1,543	1,543
採權益法認列關聯企業變動數	79,476	79,476	79,476
	<u>\$ 2,134,317</u>	<u>2,166,799</u>	<u>2,166,799</u>

依公司法規定，資本公積需優先填補虧損後，始得按股東原有股份之比例以已實現之資本公積發給新股或現金。前項所稱之已實現資本公積，包括超過票面金額發行股票所得之溢額及受領贈與之所得。依發行人募集與發行有價證券處理準則規定，每年撥充之合計金額，不得超過實收資本額百分之十。

3.法定盈餘公積

公司無虧損時，得經股東會決議，以法定盈餘公積發給新股或現金，以該項公積超過實收資本額百分之二十五之部分為限。

4.特別盈餘公積

本公司依證券主管機關規定於分派盈餘時，應就當年度發生之股東權益減項自可分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，不得分派。嗣後股東權益減項數額有迴轉時，得就迴轉部份分派盈餘。

本公司於首次採用金管會認可之國際財務報導準則時，因選擇適用國際財務報導準則第1號「首次採用國際財務報導準則」豁免項目，而帳列股東權益項下之土地重估增值及累積轉換調整數依規定轉入保留盈餘之金額為302,149千元，依金管會規定提列相同數額之特別盈餘公積，並於使用、處分或重分類相關資產時，得就原提列特別盈餘公積之比例予以迴轉分派盈餘。截至民國一一一年及一一〇年六月三十日止，該項特別盈餘公積餘額皆為302,149千元。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

依金管會規定，本公司於分派可分配盈餘時，就當年度發生之帳列其他股東權益減項淨額與上段所提列特別盈餘公積餘額之差額，自當期稅後淨利加計當期稅後淨利以外項目計入當期末分配盈餘之數額與前期未分配盈餘補提列特別盈餘公積；屬前期累積之其他股東權益減項金額，則自前期未分配盈餘補提列特別盈餘公積不得分派。嗣後其他股東權益減項數額有迴轉時，得就迴轉部份分派盈餘。

5. 盈餘分派及股利政策

依本公司章程規定，年度總決算如有盈餘，依法繳納稅捐，再提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列；其餘額再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，併同累計未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，股東股利之發放由董事會擬妥盈餘分配案，經股東會決議後辦理，其中現金股利不得低於股票股利總額之百分之十，但現金股利每股若低於0.2元則不予以發放改以股票股利發放。

本公司分別於民國一一一年六月二十一日及一一〇年七月二十六日經股東常會決議民國一一〇年度及一〇九年度盈餘分配案，有關分派予股東情形如下：

	110年度		109年度	
	配股率(元)	金額	配股率(元)	金額
分派予普通股業主之股利：				
現金	\$ 2.50	<u>658,714</u>	1.50	<u>395,228</u>

6. 庫藏股票

本公司依證券交易法第二十八條之二規定，為轉讓股份予員工，截至民國一一〇年六月三十日止買回庫藏股為1,600千股，買回成本為85,482千元。本公司於民國一一一年一月註銷庫藏股票1,600千股，計85,482千元，請詳股本之說明。

本公司持有之庫藏股票依證券交易法規定不得質押，於未轉讓前，並不得享有股東權益。

另，截至民國一一一年及一一〇年六月三十日止，子公司鼎翰科技持有本公司普通股為14,800千股及13,600千股，買回成本為506,043千元及421,508千元，列於庫藏股票項下。

本公司於民國一一一年度及一一〇年度，將子公司鼎翰科技持有本公司普通股所享之股利收入分別為37,000千元及20,400千元，自採用權益法認列子公司利益之份額轉列資本公積-庫藏股票交易項下。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

7.其他權益

	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額
民國111年1月1日	\$ (531,125)
換算國外營運機構淨資產所產生之兌換差額	143,178
民國111年6月30日餘額	<u>\$ (387,947)</u>
民國110年1月1日	\$ (459,300)
換算國外營運機構淨資產所產生之兌換差額	(83,203)
民國110年6月30日餘額	<u>\$ (542,503)</u>

(十八)股份基礎給付

合併公司民國一一年及一一〇年一月一日至六月三十日間股份基礎給付無重大變動，相關資訊請參閱民國一一〇年度合併財務報告。

(十九)客戶合約之收入

1.收入之細分

	111年4月至6月		
	整流器 部 門	條碼列印機 部 門	合 計
主要地區市場：			
亞 洲	\$ 1,176,999	588,113	1,765,112
美 洲	267,776	1,064,746	1,332,522
歐 洲	449,919	389,425	839,344
其 他	27,725	-	27,725
	<u>\$ 1,922,419</u>	<u>2,042,284</u>	<u>3,964,703</u>
主要產品線：			
整流器	\$ 1,922,419	-	1,922,419
條碼列印機	-	2,042,284	2,042,284
	<u>\$ 1,922,419</u>	<u>2,042,284</u>	<u>3,964,703</u>
	110年4月至6月		
	整流器 部 門	條碼列印機 部 門	合 計
主要地區市場：			
亞 洲	\$ 941,626	556,173	1,497,799
美 洲	160,658	796,006	956,664
歐 洲	330,705	383,707	714,412
其 他	62,508	-	62,508
	<u>\$ 1,495,497</u>	<u>1,735,886</u>	<u>3,231,383</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

		110年4月至6月		
		整流器 部 門	條碼列印機 部 門	合 計
主要產品線：				
	整流器	\$ 1,495,497	-	1,495,497
	條碼列印機	-	1,735,886	1,735,886
		<u>\$ 1,495,497</u>	<u>1,735,886</u>	<u>3,231,383</u>
		111年1月至6月		
		整流器 部 門	條碼列印機 部 門	合 計
主要地區市場：				
	亞 洲	\$ 2,324,683	1,088,261	3,412,944
	美 洲	553,867	1,989,647	2,543,514
	歐 洲	962,394	726,459	1,688,853
	其 他	71,320	-	71,320
		<u>\$ 3,912,264</u>	<u>3,804,367</u>	<u>7,716,631</u>
主要產品線：				
	整流器	\$ 3,912,264	-	3,912,264
	條碼列印機	-	3,804,367	3,804,367
		<u>\$ 3,912,264</u>	<u>3,804,367</u>	<u>7,716,631</u>
		110年1月至6月		
		整流器 部 門	條碼列印機 部 門	合 計
主要地區市場：				
	亞 洲	\$ 1,789,123	990,179	2,779,302
	美 洲	339,761	1,553,283	1,893,044
	歐 洲	651,932	717,365	1,369,297
	其 他	68,302	-	68,302
		<u>\$ 2,849,118</u>	<u>3,260,827</u>	<u>6,109,945</u>
主要產品線：				
	整流器	\$ 2,849,118	-	2,849,118
	條碼列印機	-	3,260,827	3,260,827
		<u>\$ 2,849,118</u>	<u>3,260,827</u>	<u>6,109,945</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

2.合約餘額

	<u>111.6.30</u>	<u>110.12.31</u>	<u>110.6.30</u>
應收票據及應收帳款	\$ 3,411,848	2,990,996	2,759,247
減：備抵損失	(42,637)	(39,430)	(31,224)
合 計	<u>\$ 3,369,211</u>	<u>2,951,566</u>	<u>2,728,023</u>

應收票據及應收帳款及其減損之揭露請詳附註六(三)。

(二十)營業外收益及費損

1.利息收入

合併公司之利息收入明細如下：

	<u>111年4月至6月</u>	<u>110年4月至6月</u>	<u>111年1月至6月</u>	<u>110年1月至6月</u>
銀行存款利息	\$ <u>3,522</u>	<u>4,025</u>	<u>6,850</u>	<u>7,199</u>

2.其他收入

	<u>111年4月至6月</u>	<u>110年4月至6月</u>	<u>111年1月至6月</u>	<u>110年1月至6月</u>
租金收入	\$ 2,376	2,184	4,627	4,392
出售選擇權權利金收入	-	-	-	251
其 他	12,557	16,603	22,288	30,407
	<u>\$ 14,933</u>	<u>18,787</u>	<u>26,915</u>	<u>35,050</u>

3.其他利益及損失

	<u>111年4月至6月</u>	<u>110年4月至6月</u>	<u>111年1月至6月</u>	<u>110年1月至6月</u>
處分不動產、廠房及設備利益(損失)	\$ 1,425	(475)	857	(609)
處分投資利益	-	-	-	232
外幣兌換利益(損失)	74,959	(4,910)	143,277	1,198
透過損益按公允價值衡量之金融工具利益(損失)	(17,339)	4,149	(32,322)	1,296
不動產、廠房及設備減損迴轉利益(損失)	(165)	(2,707)	546	(2,707)
其 他	(3,362)	(2,158)	(5,925)	(3,660)
	<u>\$ 55,518</u>	<u>(6,101)</u>	<u>106,433</u>	<u>(4,250)</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

4.財務成本

	111年4月至6月	110年4月至6月	111年1月至6月	110年1月至6月
利息費用	\$ (8,170)	(7,293)	(14,955)	(17,457)
減：利息資本化	86	845	304	1,427
其他財務費用	(546)	(524)	(1,058)	(983)
	<u>\$ (8,630)</u>	<u>(6,972)</u>	<u>(15,709)</u>	<u>(17,013)</u>

(廿一)員工及董事酬勞

依本公司章程規定，本公司年度如有獲利，應先提撥至少百分之四，但以不超過百分之十為員工酬勞，並提撥不超過百分之一為董事酬金。

本公司如有以前年度累積虧損，於當年度有獲利須提撥員工酬勞及董事酬勞金之前，應先彌補虧損，其餘額再依前項比例提撥；又員工酬勞以股票或現金發放時，發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工。

前項董事酬勞金僅得以現金為之。員工酬勞及董事酬勞金分派案，應由董事會決議，並報告股東會。

本公司民國一一一年及一一〇年四月一日至六月三十日及一一一年及一一〇年一月一日至六月三十日員工酬勞估列金額分別為31,379千元、14,215千元、60,729千元及25,495千元，董事酬勞金估列金額分別為178千元、2,374千元、5,068千元及4,255千元，係以本公司各該段期間之稅前淨利扣除員工及董事酬勞前之金額乘上本公司章程訂定之員工酬勞及董事酬勞分派成數為估計基礎，並列報為該段期間之營業費用。若實際分派金額與估列數有差異時，則依會計估計變動處理，並將該差異列為發放年度之損益。

本公司民國一一〇年度及一〇九年度員工酬勞估列金額分別為64,897千元及37,523千元，董事酬勞金估列金額分別為10,816千元及6,254千元，係以本公司各該段期間之稅前淨利扣除員工及董事酬勞前之金額乘上本公司章程訂定之員工酬勞及董事酬勞分派成數為估計基礎，並列報為該段期間之營業費用。相關資訊可至公開資訊觀測站查詢。前述董事會決議分派之員工及董事酬勞金額與本公司民國一一〇年度及一〇九年度合併財務報告估列金額並無差異。

(廿二)每股盈餘

1.基本每股盈餘

	111年4月至6月	110年4月至6月	111年1月至6月	110年1月至6月
本期淨利	\$ <u>384,888</u>	<u>179,623</u>	<u>770,924</u>	<u>360,877</u>
加權平均流通在外				
股數(千股)	<u>248,685</u>	<u>249,885</u>	<u>249,072</u>	<u>247,256</u>
基本每股盈餘(元)	\$ <u>1.55</u>	<u>0.72</u>	<u>3.10</u>	<u>1.46</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

2.稀釋每股盈餘

	<u>111年4月至6月</u>	<u>110年4月至6月</u>	<u>111年1月至6月</u>	<u>110年1月至6月</u>
本期淨利	\$ 384,888	179,623	770,924	360,877
轉換公司債利息費				
用之稅後影響數	-	-	-	1,549
計算稀釋每股盈餘				
之本期淨利	<u>\$ 384,888</u>	<u>179,623</u>	<u>770,924</u>	<u>362,426</u>
加權平均流通在外				
股數(千股)	248,685	249,885	249,072	247,256
員工酬勞	441	212	1,221	684
轉換公司債轉換之				
影響	-	-	-	3,041
用以計算稀釋每股				
盈餘之當期流通				
在外普通股加權				
平均股數(千股)	<u>249,126</u>	<u>250,097</u>	<u>250,293</u>	<u>250,981</u>
稀釋每股盈餘(元)	<u>\$ 1.54</u>	<u>0.72</u>	<u>3.08</u>	<u>1.44</u>

(廿三)金融工具

1.信用風險

(1)信用風險之暴險

金融資產之帳面金額代表最大信用暴險金額。

(2)信用風險集中情況

由於合併公司有廣大客戶群，並未顯著集中與單一客戶進行交易，並無銷貨收入佔營業收入金額10%。

(3)應收款項及債券之信用風險

應收票據及應收帳款之信用風險暴險資訊請詳附註六(三)。

2.流動性風險

下表為金融負債之合約到期日，包含估計利息但不包含淨額協議之影響。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

	帳面金額	合約 現金流量	1年	1-2年	2-5年	超過5年
111年6月30日						
非衍生金融負債						
短期借款	\$ 1,135,034	1,137,624	1,137,624	-	-	-
應付帳款	1,764,263	1,764,263	1,764,263	-	-	-
其他應付款	1,829,927	1,829,927	1,829,927	-	-	-
租賃負債	241,954	256,568	106,893	92,605	57,070	-
存入保證金	2,527	2,527	2,527	-	-	-
長期借款(含一年內到期)	1,439,330	1,453,742	115,894	799,790	532,719	5,339
衍生金融負債						
遠期外匯合約	14,361	14,361	14,361	-	-	-
	<u>\$ 6,427,396</u>	<u>6,459,012</u>	<u>4,971,489</u>	<u>892,395</u>	<u>589,789</u>	<u>5,339</u>
110年12月31日						
非衍生金融負債						
短期借款	\$ 921,426	922,118	922,118	-	-	-
應付票據及帳款	1,675,156	1,675,156	1,675,156	-	-	-
其他應付款	883,040	883,040	883,040	-	-	-
租賃負債	304,151	320,569	125,922	95,349	99,298	-
存入保證金	2,347	2,347	2,347	-	-	-
長期借款(含一年內到期)	1,549,310	1,579,765	21,960	235,155	1,290,913	31,737
衍生金融負債						
遠期外匯合約	563	563	563	-	-	-
	<u>\$ 5,335,993</u>	<u>5,383,558</u>	<u>3,631,106</u>	<u>330,504</u>	<u>1,390,211</u>	<u>31,737</u>
110年6月30日						
非衍生金融負債						
短期借款	\$ 1,341,862	1,343,467	1,343,467	-	-	-
應付帳款	1,527,741	1,527,741	1,527,741	-	-	-
其他應付款	1,395,460	1,395,460	1,395,460	-	-	-
租賃負債	340,772	368,843	113,225	124,909	130,649	60
存入保證金	2,340	2,340	2,340	-	-	-
長期借款(含一年內到期)	1,061,280	1,083,399	8,731	254,731	819,704	233
衍生金融負債						
遠期外匯合約	2,205	2,205	2,205	-	-	-
	<u>\$ 5,671,660</u>	<u>5,723,455</u>	<u>4,393,169</u>	<u>379,640</u>	<u>950,353</u>	<u>293</u>

合併公司並不預期到期日分析之現金流量發生時點會顯著提早，或實際金額會有顯著不同。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

3.匯率風險

(1)匯率風險之暴險

合併公司暴露於重大外幣匯率風險之金融資產及負債如下：

	111.6.30		110.12.31		110.6.30	
	匯率	台幣	匯率	台幣	匯率	台幣
<u>金融資產</u>						
<u>貨幣性項目</u>						
美金	\$ 29.72	2,493,907	27.68	2,264,903	27.86	1,716,189
歐元	31.05	919,796	31.32	744,326	33.15	732,762
日幣	0.2182	196,026	0.2405	171,703	0.2521	151,061
港幣	3.7880	505,129	3.5490	484,125	3.5870	536,691
人民幣	4.4390	2,125,126	4.3440	1,678,553	4.3090	1,554,514
韓元	0.0229	1,220	0.0233	2,120	0.0248	1,424
		<u>\$ 6,241,204</u>		<u>5,345,730</u>		<u>4,692,641</u>
<u>衍生商品</u>						
美元	\$ 29.72	691	27.68	4,702	27.86	2,047
歐元	31.05	1,384	31.32	333	33.15	1,426
		<u>\$ 2,075</u>		<u>5,035</u>		<u>3,473</u>
<u>金融負債</u>						
<u>貨幣性項目</u>						
美元	\$ 29.72	861,526	27.68	743,173	27.86	877,815
歐元	31.05	399,742	31.32	262,425	33.15	257,557
日幣	0.2182	63,003	0.2405	46,080	0.2521	64,282
港幣	3.7880	1,325	3.5490	1,385	3.587	1,352
人民幣	4.4390	824,939	4.3440	837,737	4.3090	686,611
韓元	0.0229	1,227	0.0233	2,141	0.0248	1,442
		<u>\$ 2,151,762</u>		<u>1,892,941</u>		<u>1,889,059</u>
<u>衍生商品</u>						
美元	\$ 29.72	14,361	27.68	516	27.86	1,975
歐元	31.05	-	31.32	47	33.15	230
		<u>\$ 14,361</u>		<u>563</u>		<u>2,205</u>

(2)敏感性分析

合併公司貨幣性項目之匯率風險主要來自於以外幣計價之金融資產及金融負債，於換算時產生外幣兌換損益。於民國一一一年及一一〇年六月三十日當新台幣相對於上表所列外幣貶值或升值3%，而其他所有因素維持不變之情況下，民國一一一年及一一〇年一月一日至六月三十日之稅前淨利將分別增加或減少122,315千元及84,146千元；兩期分析係採用相同基礎。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(3) 貨幣性項目之兌換損益

由於合併公司功能性貨幣種類繁多，故採彙整方式揭露貨幣性項目之兌換損益資訊，民國一一一年及一一〇年四月一日至六月三十日及一一一年及一一〇年一月一日至六月三十日外幣兌換(損)益(含已實現及未實現)分別為74,959千元、(4,910)千元、143,277千元及1,198千元。

4. 利率分析

合併公司之金融資產及金融負債利率暴險於本附註之流動性風險管理中說明。

下列敏感度分析係依衍生及非衍生工具於報導日之利率暴險而決定。對於浮動利率負債，其分析方式係假設報導日流通在外之負債金額於整年度皆流通在外。合併公司內部向主要管理階層報告利率時所使用之變動率為利率增加或減少1%，此亦代表管理階層對利率之合理可能變動範圍之評估。

若利率增加或減少1%，在所有其他變數維持不變之情況下，合併公司民國一一一年及一一〇年一月一日至六月三十日之稅前淨利將減少或增加25,744千元及24,031千元，主因係合併公司之變動利率銀行借款所致。

5. 其他價格風險：

如報導日權益證券價格變動(兩期分析係採用相同基礎，且假設其他變動因素不變)，對綜合損益項目之影響如下：

<u>報導日證券價格</u>	<u>111年1月至6月</u>		<u>110年1月至6月</u>	
	<u>其他綜合損益稅後金額</u>	<u>稅後損益</u>	<u>其他綜合損益稅後金額</u>	<u>稅後損益</u>
上漲1%	\$ -	2,303	-	-
下跌1%	\$ -	(2,303)	-	-

6. 公允價值資訊

(1) 金融工具之種類及公允價值

合併公司透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債係以重複性為基礎，按公允價值衡量。各種類金融資產及金融負債之帳面金額及公允價值(包括公允價值等級資訊，但非按公允價值衡量金融工具之帳面金額為公允價值之合理近似值者，及於活絡市場無報價且公允價值無法可靠衡量之權益工具投資，依規定無須揭露公允價值資訊)列示如下：

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

	111.6.30				
	帳面金額	公允價值			合計
		第一級	第二級	第三級	
透過損益按公允價值衡量之金					
融資產					
受益憑證	\$ 230,267	230,267	-	-	230,267
衍生金融資產	2,075	-	2,075	-	2,075
小計	232,342	230,267	2,075	-	232,342
放款及應收款					
現金及約當現金	2,858,561	-	-	-	-
應收票據及帳款	3,369,211	-	-	-	-
其他應收款	73,129	-	-	-	-
其他金融資產	603,592	-	-	-	-
小計	6,904,493	-	-	-	-
合計	\$ 7,136,835	230,267	2,075	-	232,342
透過損益按公允價值衡量之金					
融負債					
衍生金融負債	\$ 14,361	-	14,361	-	14,361
按攤銷後成本衡量之金融負債					
銀行借款	2,574,364	-	-	-	-
應付帳款	1,764,263	-	-	-	-
其他應付款	1,829,927	-	-	-	-
租賃負債	241,954	-	-	-	-
存入保證金	2,527	-	-	-	-
小計	6,413,035	-	-	-	-
合計	\$ 6,427,396	-	14,361	-	14,361
110.12.31					
	帳面金額	公允價值			合計
		第一級	第二級	第三級	
透過損益按公允價值衡量之金					
融資產					
受益憑證	\$ 150,032	150,032	-	-	150,032
衍生金融資產	5,035	-	5,035	-	5,035
小計	155,067	150,032	5,035	-	155,067

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

	110.12.31				
	帳面金額	公允價值			合計
		第一級	第二級	第三級	
放款及應收款					
現金及約當現金	2,701,648	-	-	-	-
應收票據及帳款	2,951,566	-	-	-	-
其他應收款	63,284	-	-	-	-
其他金融資產	445,167	-	-	-	-
小計	6,161,665	-	-	-	-
合計	<u>\$ 6,316,732</u>	<u>150,032</u>	<u>5,035</u>	<u>-</u>	<u>155,067</u>
透過損益按公允價值衡量之金融負債					
衍生金融負債	\$ 563	-	563	-	563
按攤銷後成本衡量之金融負債					
銀行借款	2,470,736	-	-	-	-
應付票據及帳款	1,675,156	-	-	-	-
其他應付款	883,040	-	-	-	-
租賃負債	304,151	-	-	-	-
存入保證金	2,347	-	-	-	-
小計	5,335,430	-	-	-	-
合計	<u>\$ 5,335,993</u>	<u>-</u>	<u>563</u>	<u>-</u>	<u>563</u>
	110.6.30				
	帳面金額	公允價值			合計
		第一級	第二級	第三級	
透過損益按公允價值衡量之金融資產					
衍生金融資產	\$ 3,473	-	3,473	-	3,473
放款及應收款					
現金及約當現金	2,712,377	-	-	-	-
應收票據及帳款	2,728,023	-	-	-	-
其他應收款	47,907	-	-	-	-
其他金融資產	498,622	-	-	-	-
小計	5,986,929	-	-	-	-
合計	<u>\$ 5,990,402</u>	<u>-</u>	<u>3,473</u>	<u>-</u>	<u>3,473</u>
透過損益按公允價值衡量之金融負債					
衍生金融負債	\$ 2,205	-	2,205	-	2,205

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

按攤銷後成本衡量之金融負債	110.6.30				
	帳面金額	公允價值			合計
		第一級	第二級	第三級	
銀行借款	2,403,142	-	-	-	-
應付帳款	1,527,741	-	-	-	-
其他應付款	1,395,460	-	-	-	-
租賃負債	340,772	-	-	-	-
存入保證金	2,340	-	-	-	-
小計	5,669,455	-	-	-	-
合計	<u>\$ 5,671,660</u>	<u>-</u>	<u>2,205</u>	<u>-</u>	<u>2,205</u>

(2) 衡量公允價值所採用之評價技術及假設

A. 非衍生金融工具

金融工具如有活絡市場公開報價時，則以活絡市場之公開報價為公允價值。主要交易所及經判斷為熱門券之中央政府債券櫃台買賣中心公告之市價，皆屬上市（櫃）權益工具及有活絡市場公開報價之債務工具公允價值之基礎。

若能及時且經常自交易所、經紀商、承銷商、產業公會、訂價服務機構或主管機關取得金融工具之公開報價，且該價格代表實際且經常發生之公平市場交易者，則該金融工具有活絡市場公開報價。如上述條件並未達成，則該市場視為不活絡。一般而言，買賣價差甚大、買賣價差顯著增加或交易量甚少，皆為不活絡市場之指標。

除上述有活絡市場之金融工具外，其餘金融工具之公允價值係以評價技術或參考交易對手報價取得。透過評價技術所取得之公允價值可參照其他實質上條件及特性相似之金融工具之現時公允價值、現金流量折現法或以其他評價技術，包括以報導日可取得之市場資訊運用模型計算而得(例如櫃買中心參考殖利率曲線、Reuters商業本票利率平均報價)。

B. 衍生金融工具

係根據廣為市場使用者所接受之評價模型評價，例如折現法及選擇權定價模型。遠期外匯合約通常係根據目前之遠期匯率評價。

(3) 公允價值等級間之移動

合併公司於民國一一一年及一一〇年一月一日至六月三十日公允價值衡量評價方式皆無任何層級間之移轉。

(廿四) 財務風險管理

合併公司財務風險管理目標及政策與民國一一〇年度合併財務報告所揭露者無重大變動。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(廿五)資本管理

合併公司資本管理目標、政策及程序與民國一一〇年度合併財務報告所揭露者一致；另作為資本管理之項目之彙總量化資料與民國一一〇年度合併財務報告所揭露者亦無重大變動。相關資訊請參閱民國一一〇年度合併財務報告。

(廿六)非現金交易之投資及籌資活動

合併公司於民國一一一年及一一〇年一月一日至六月三十日並無非現金交易投資及籌資活動。

來自籌資活動之負債之調節如下表：

	111.1.1	現金流量	非現金之變動			111.6.30
			匯率變動	其他	租賃給付之變動	
短期借款	\$ 921,426	213,608	-	-	-	1,135,034
長期借款(含一年內到期)	1,549,310	(109,980)	-	-	-	1,439,330
租賃負債	304,151	(78,893)	8,172	5,159	3,365	241,954
存入保證金	2,347	180	-	-	-	2,527
來自籌資活動之負債總額	<u>\$ 2,777,234</u>	<u>24,915</u>	<u>8,172</u>	<u>5,159</u>	<u>3,365</u>	<u>2,818,845</u>

	110.1.1	現金流量	非現金之變動			110.6.30
			匯率變動	其他	租賃給付之變動	
應付公司債	\$ 778,947	(41,900)	-	(737,047)	-	-
短期借款	1,401,954	(60,092)	-	-	-	1,341,862
長期借款(含一年內到期)	1,299,550	(238,270)	-	-	-	1,061,280
租賃負債	311,097	(42,046)	(5,826)	(805)	78,352	340,772
存入保證金	2,382	(42)	-	-	-	2,340
來自籌資活動之負債總額	<u>\$ 3,793,930</u>	<u>(382,350)</u>	<u>(5,826)</u>	<u>(737,852)</u>	<u>78,352</u>	<u>2,746,254</u>

七、關係人交易

(一)母公司與最終控制者

本公司為合併公司之最終控制者。

(二)主要管理人員報酬

主要管理人員報酬包括：

	111年4月至6月	110年4月至6月	111年1月至6月	110年1月至6月
短期員工福利	\$ 50,945	40,318	95,982	80,131
退職後福利	318	310	636	681
股份基礎給付	2,871	1,432	3,803	2,615
	<u>\$ 54,134</u>	<u>42,060</u>	<u>100,421</u>	<u>83,427</u>

有關股份基礎給付之說明請詳附註六(十八)。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

八、質押之資產：無。

九、重大或有負債及未認列之合約承諾

合併公司向銀行融資而提供之保證票據明細如下：

	<u>111.6.30</u>	<u>110.12.31</u>	<u>110.6.30</u>
新台幣	\$ 2,469,210	2,469,210	2,695,100
美金	21,000	21,000	21,000

截至民國一一一年及一一〇年六月三十日止，合併公司無已開立信用狀尚未使用餘額。

十、重大之災害損失：無。

十一、重大之期後事項：無。

十二、其 他

(一)員工福利、折舊、折耗及攤銷費用功能別彙總如下：

功 能 別 性 質 別	111年4月至6月			110年4月至6月		
	屬於營業 成本者	屬於營業 費用者	合 計	屬於營業 成本者	屬於營業 費用者	合 計
員工福利費用						
薪資費用	268,263	330,828	599,091	229,778	269,692	499,470
勞健保費用	27,891	22,938	50,829	21,290	22,314	43,604
退休金費用	14,899	14,264	29,163	12,423	12,532	24,955
董事酬金	-	17,002	17,002	-	11,571	11,571
其他員工福利費用	22,274	8,042	30,316	17,855	7,041	24,896
折舊費用	167,798	28,291	196,089	152,346	28,306	180,652
攤銷費用	3,593	31,186	34,779	157	30,324	30,481

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

功 能 別 性 質 別	111年1月至6月			110年1月至6月		
	屬於營業 成本者	屬於營業 費用者	合 計	屬於營業 成本者	屬於營業 費用者	合 計
員工福利費用						
薪資費用	519,909	629,446	1,149,355	445,262	533,235	978,497
勞健保費用	52,715	48,715	101,430	41,929	44,500	86,429
退休金費用	29,557	28,426	57,983	24,515	24,914	49,429
董事酬金	-	28,551	28,551	-	20,883	20,883
其他員工福利費用	45,249	15,247	60,496	36,010	14,260	50,270
折舊費用	332,566	56,458	389,024	307,328	56,377	363,705
攤銷費用	7,186	60,441	67,627	247	60,606	60,853

(二)其他事項：

民國一〇九年一月全球爆發新冠肺炎疫情並造成大流行，進而對國際未來經濟及金融發展造成重大之不確定性，截至合併財務報告通過發布日止，合併公司評估新冠肺炎疫情對合併公司之繼續經營能力、資產減損、籌資風險並未造成重大影響。合併公司將持續觀察及評估疫情對前述方面之影響。

十三、附註揭露事項

(一)重大交易事項相關資訊

民國一一年第二季合併公司依編製準則之規定，應再揭露之重大交易事項相關資訊如下：

1. 資金貸與他人：

單位：新台幣千元

編號	貸出資金 之公司	貸與 對象	往來 科目	是否 為關 係人	本期最 高金額 (註4)	期末 餘額	實際動 支金額	利率 區間	資金貸 與性質 (註1)	業務 往來 金額	有短期融 通資金必 要之原因	提列備 抵損失 金額	擔 保 品		對個別對象資 金貸與 限額(註2)	資金貸 與限額 (註3)
													名稱	價值		
1	鼎翰科技	TSCAA	其他應 收款	是	208,040	208,040	133,740	1.90%	2	-	營運周轉	-	無	-	822,919	1,645,839
2	鼎翰科技	DLS	其他應 收款	是	297,200	297,200	178,320	1.10%	2	-	營運周轉	-	無	-	822,919	1,645,839

註1：短期融通資金之必要者。

註2：鼎翰科技資金貸與有短期融通資金性質之公司或行號，個別對象貸與金額以不超過鼎翰科技淨值20%為限。

註3：鼎翰科技資金貸與他人之總額以不超過鼎翰科技淨額40%為限。

註4：係按民國一一年六月三十日美金匯率29.72換算台幣表達。

2. 為他人背書保證：

單位：新台幣千元

編 號	背書保 證者公 司名稱	被背書保證對象		對單一企 業背書保 證限額(註 2)	本期最高 背書保證 餘額(註4)	期末背 書保證 餘 額	實際動 支金額	以財產擔 保之背書 保證金額	累計背書保證金 額佔最近期財務 報表淨值之比率	背書保 證最高 限額(註3)	屬母公司 對子公司 背書保證	屬子公司 對母公司 背書保證	屬對大陸 地區背書 保 證
		公司名稱	關係 (註1)										
1	鼎翰科技	TSCAA	2	1,645,839	356,640	356,640	-	-	8.67 %	2,468,758	N	N	N

註1：本公司之子公司。

註2：鼎翰科技對單一企業背書保證限額以不超過鼎翰科技淨值40%為限。

註3：鼎翰科技背書保證限額以不超過鼎翰科技淨值60%為限。

註4：係按民國一一年六月三十日美金匯率29.72換算台幣表達。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

3. 期末持有有價證券情形(不包含投資子公司、關聯企業及合資權益部分)：

單位：新台幣千元

持有之公司	有價證券種類及名稱	與有價證券發行人之關係	帳列科目	期 末				備 註
				股 數	帳面金額	持股比率	公允價值	
本公司	日盛貨幣市場基金	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	6,671	100,130	-	100,130	
本公司	台新1699貨幣市場基金	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	9,498	130,137	-	130,137	
本公司	Applied Wireless Identifications Group, Inc.	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	243	-	-	-	
本公司	Third Dimension (3D) Semiconductor, Inc.	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	921	-	-	-	

4. 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。

5. 取得不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。

6. 處分不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。

7. 與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：

單位：新台幣千元

進(銷)貨之公司	交易對象名稱	關係	交易情形				交易條件與一般交易不同之情形及原因		應收(付)票據、帳款		備註
			進(銷)貨	金額	佔總進(銷)貨之比率	授信期間(註1)	單價	授信期間	餘額	佔總應收(付)票據、帳款之比率	
本公司	TSCJ	子公司	銷貨	(228,154)	(3) %		-		85,464	3 %	
本公司	TSCH	子公司	銷貨	(433,823)	(6) %		-		336,190	10 %	
本公司	TSCA	孫公司	銷貨	(243,893)	(3) %		-		193,848	6 %	
本公司	陽信長威	孫公司	進貨	1,307,009	26 %		-		(492,531)	(28) %	註2
本公司	天津長威	孫公司	進貨	196,490	4 %		-		(11,383)	(1) %	
本公司	上海瀚科	孫公司	進貨	216,895	4 %		-		(52,679)	(3) %	註2
鼎翰科技	TSCAE	子公司	銷貨	(571,733)	(7) %		-		548,719	16 %	
鼎翰科技	天津國聚	子公司	銷貨	(323,645)	(4) %		-		166,830	5 %	
鼎翰科技	天津國聚	子公司	進貨	362,631	7 %		-		(262,461)	(15) %	
鼎翰科技	TSCAA	子公司	銷貨	(300,143)	(4) %		-		341,218	10 %	

註1：月結30-135天，必要時視其資金需求調整之。

註2：應付帳款係以淨額列示。

註3：相關交易業已沖銷，請參見附註十三(一)10。

8. 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：

單位：新台幣千元

帳列應收款項之公司	交易對象名稱	關係	應收關係人款項餘額	週轉率	逾期應收關係人款項		應收關係人款項期後收回金額(註1)	提列備抵損失金額
					金額	處理方式		
本公司	TSCH	子公司	336,190	2.52%	-		87,730	-
本公司	TSCA	孫公司	193,848	3.09%	-		52,863	-
鼎翰科技	TSCAE	子公司	548,719	2.32%	-		158,057	-
鼎翰科技	TSCAE	子公司	428	-	-		-	-
鼎翰科技	天津國聚	子公司	166,830	6.05%	-		95,873	-
鼎翰科技	天津國聚	子公司	1	-	-		1	-
鼎翰科技	TSCAA	子公司	341,218	2.17%	-		50,134	-
鼎翰科技	TSCAA	子公司	138,622	-	-		-	-
鼎翰科技	DLS	子公司	179,767	-	-		-	-
天津國聚	鼎翰科技	子公司	262,461	3.34%	-		87,078	-

註1：截至查核報告日止。

註2：相關交易業已沖銷，請參見附註十三(一)10。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

9.從事衍生工具交易：請詳附註六(二)。

10.母子公司間業務關係及重要交易往來情形：

編號	交易人名稱	交易往來對象	與交易人之關係	111年第二季交易往來情形			佔合併總營業收入或總資產之比率
				科目	金額	交易條件	
0	本公司	TSCE	1	推銷費用—佣金支出	67,330	按月支付	0.84 %
0	本公司	TSCE	1	應付費用	59,934		0.34 %
0	本公司	TSCJ	1	銷貨收入	228,154	註三	2.83 %
0	本公司	TSCJ	1	應收帳款	85,464		0.49 %
0	本公司	TSCJ	1	其他應收款	35		- %
0	本公司	TSCH	1	銷貨收入	433,823	按月支付	5.38 %
0	本公司	TSCH	1	應收帳款	336,190		1.92 %
0	本公司	TSCH	1	其他應收款	473		- %
0	本公司	TSCH	1	應付費用	68		- %
0	本公司	鼎翰科技	1	銷貨收入	1,668	註三	0.02 %
0	本公司	鼎翰科技	1	應收帳款	1,095		0.01 %
0	本公司	鼎翰科技	1	進貨	8		- %
0	本公司	TSCA	1	銷貨收入	243,893	註三	3.03 %
0	本公司	TSCA	1	推銷費用—佣金支出	5,761		0.07 %
0	本公司	TSCA	1	應收帳款	193,848		1.11 %
0	本公司	TSCA	1	應付費用	1,006		0.01 %
0	本公司	上海瀚科	1	銷貨收入	98,084	按月支付	1.22 %
0	本公司	上海瀚科	1	應收帳款	70,817		0.40 %
0	本公司	上海瀚科	1	其他應收款	112		- %
0	本公司	上海瀚科	1	進貨	216,895		2.69 %
0	本公司	上海瀚科	1	應付帳款	123,495		0.71 %
0	本公司	陽信長威	1	進貨	1,307,009	註四	16.22 %
0	本公司	陽信長威	1	應付帳款	492,531	註五	2.81 %
0	本公司	天津長威	1	進貨	196,490		2.44 %
0	本公司	天津長威	1	應付帳款	11,383		0.06 %
0	本公司	天津長威	1	其他應付款	114,034		0.65 %
1	TSCE	本公司	2	銷貨收入	67,330	註三	0.84 %
1	TSCE	本公司	2	應收帳款	59,934		0.34 %
2	TSCH	TSCE	3	佣金支出	1,514		0.02 %
2	TSCH	TSCE	3	應付費用	285		- %
3	TSCA	TSCAA	3	其他應付費用	695		- %
3	TSCA	TSCAA	3	其他應收款	1,471		0.01 %
4	陽信長威	本公司	2	銷貨收入	1,307,009	註三	16.22 %
4	陽信長威	本公司	2	應收帳款	492,531		2.81 %
4	陽信長威	上海瀚科	3	銷貨收入	632,653	註三	7.85 %
4	陽信長威	上海瀚科	3	應收帳款	409,278		2.34 %

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

編號	交易人名稱	交易往來對象	與交易人之關係	111年第二季交易往來情形			
				科目	金額	交易條件	佔合併總營業收入或總資產之比率
5	天津長威	本公司	2	銷貨收入	196,490	註三	2.44 %
5	天津長威	本公司	2	應收帳款	11,383		0.06 %
5	天津長威	本公司	2	其他應收款	114,034		0.65 %
5	天津長威	陽信長威	3	銷貨收入	73,842	註三	0.92 %
5	天津長威	陽信長威	3	應收帳款	33,964		0.19 %
5	天津長威	上海瀚科	3	其他應收款	2,460		0.01 %
5	天津長威	上海瀚科	3	其他營業外收入	6,529		0.08 %
5	天津長威	上海瀚科	3	其他營業外收入	640		0.01 %

註一、編號之填寫方式如下：

1.0代表母公司。

2.子公司依公司別由阿拉伯數字1開始依序編號。

註二、與交易人之關係種類標示如下：

1.母公司對子公司。

2.子公司對母公司。

3.子公司對子公司。

註三：銷售價格按一般市場價格為準。收款期間為月結90~180天。

註四：加工費係採成本加成，收款期間為月結90~180天。

註五：付款期限為進貨後月結180天。

(二)轉投資事業相關資訊：

民國一一年第二季合併公司之轉投資事業資訊如下：

單位：新台幣千元

投資公司名稱	被投資公司名稱	所在地區	主要營業項目	原始投資金額		期末持有			被投資公司本期損益	本期認列之投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額			
本公司	Ever Energetic	英屬維京群島	對各種生產事業之投資及一般進出口業務	665,501	665,501	21,175	100.00 %	1,543,535	109,948	109,948	子公司(註2)
本公司	Ever Winner	英屬維京群島	對各種生產事業之投資及一般進出口業務	465,127	465,127	16,010	100.00 %	1,762,886	213,542	213,542	子公司(註2)
本公司	Skyrise	英屬維京群島	對各種生產事業之投資及一般進出口業務	2,845	2,845	50	100.00 %	1,791	(50)	(50)	子公司(註2)
本公司	TSCE	德國	一般進出口業務	10,972	10,972	-	100.00 %	46,025	13,579	13,579	子公司(註2)
本公司	TSCJ	日本	整流器之買賣業務	28,689	28,689	2	100.00 %	98,123	17,788	17,788	子公司(註1)
本公司	TSCH	香港	對各種生產事業之投資及整流器之買賣業務	282,312	282,312	672	25.22 %	619,146	161,246	38,606	子公司(註2)
本公司	鼎翰科技	台灣	條碼印表機之製造及買賣	163,728	163,728	15,453	36.38 %	776,142	453,922	165,137	子公司(註1)
Ever Energetic	TSCA	美國	整流器之買賣業務	258,520	258,520	6,750	75.00 %	268,493	67,134	50,350	子公司(註2)
Ever Energetic	TSCH	香港	對各種生產事業之投資及整流器之買賣業務	571,628	571,628	985	36.96 %	1,201,314	161,246	59,597	子公司(註2)
Ever Winner	TSCA	美國	整流器之買賣業務	83,813	83,813	2,250	25.00 %	89,498	67,134	16,784	子公司(註2)
Ever Winner	上海瀚科	中國大陸	整流器之買賣業務	4,461	4,461	-	100.00 %	369,447	135,862	135,862	子公司(註2)
Ever Winner	TSCH	香港	對各種生產事業之投資及整流器之買賣業務	792,254	792,254	1,008	37.82 %	1,229,267	161,246	60,983	子公司(註2)
TSCH	陽信長威	中國大陸	整流器之製造及買賣業務	966,119	966,119	-	100.00 %	2,311,422	94,560	94,560	子公司(註1)
TSCH	天津長威	中國大陸	晶片之製造及買賣業務	787,044	787,044	-	100.00 %	672,061	26,901	26,901	子公司(註2)
鼎翰科技	TSCAE	德國	條碼印表機及其零件之銷售	2,943	2,943	-	100.00 %	(2,489)	10,601	10,601	子公司(註1)

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

投資公司名稱	被投資公司名稱	所在地區	主要營業項目	原始投資金額		期末持有			被投資公司本期損益	本期認列之投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額			
鼎翰科技	TSCAA	美國	條碼印表機及其零件之銷售	1,096,621	1,096,621	16,000	100.00 %	1,032,765	22,070	22,070 (註1)	子公司
鼎翰科技	TSC HK	香港	對各種生產事業之投資及一般進出口業務	51,738	51,738	11,711	100.00 %	524,550	41,818	41,818 (註1)	子公司
鼎翰科技	鼎貫科技	台灣	條碼印表機及其零件之銷售	5,000	5,000	500	100.00 %	5,431	5	5 (註1)	子公司
鼎翰科技	PTNX US	美國	條碼印表機及其零件之銷售	63,021	63,021	-	5.00 %	49,270	8,786	(326) (註1)	子公司
鼎翰科技	DLS	美國	印表機週邊耗材及各式標籤紙之客製化設計、整合及產銷	801,558	801,558	1	100.00 %	1,095,922	95,672	95,672 (註1)	子公司
鼎翰科技	TSCIN	印度	條碼印表機及其零件之銷售	2,791	2,791	710	100.00 %	2,198	(408)	(408) (註1)	子公司
TSCAE	TSCAD	阿拉伯聯合大公國	條碼印表機及其零件之銷售	8,234	8,234	-	100.00 %	(7,022)	235	235 (註1)	子公司
TSCAE	TSCAS	西班牙	條碼印表機及其零件之銷售	124	124	-	100.00 %	2,455	268	(註1)	子公司
TSCAA	PTNX US	美國	條碼印表機及其零件之銷售	45,319 (千美元)	45,319 (千美元)	-	95.00 %	1,255,192	8,786	(6,186) (註1)	子公司
DLS	PPL	美國	印表機週邊耗材及標籤紙之銷售	115 (千美元)	115 (千美元)	850	100.00 %	21,096	7,201	7,201 (註1)	子公司
TSC HK	天津國聚	中國大陸	條碼印表機及其零件之產銷	44,580	44,580	-	100.00 %	556,957	40,890	40,890 (註1)	子公司
TSC HK	深圳鼎貫	中國大陸	條碼印表機及其零件之銷售	4,577	4,577	-	100.00 %	12,617	926	926 (註1)	子公司

註1：係依據被投資公司經會計師核閱之財務報告認列。

註2：係依據被投資公司未經會計師核閱之財務報告認列。

(三)大陸投資資訊：

1.轉投資大陸地區之事業相關資訊：

單位：新台幣千元

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實收資本額	投資方式	本期期初自台灣匯出累積投資金額	本期匯出或收回投資金額		本期期末自台灣匯出累積投資金額	被投資公司本期損益	本公司直接或間接投資之持股比例	本期認列投資損益	期末投資帳面價值	截至本期止已匯回投資收益
					匯出	收回						
上海瀚科	整流器之買賣業務	4,461	(三)	4,461	-	-	4,461	135,862	100.00 %	135,862	369,447	183,810
陽信長威	整流器之買賣業務	1,667,160	(三)	628,196	-	-	628,196	94,560	100.00 %	94,560	2,311,422	250,864
天津長威	晶片之製造及買賣業務	387,173	(三)	387,173	-	-	387,173	26,901	100.00 %	26,901	672,061	452,102
天津國聚	條碼印表機及其零件之產銷	46,610	(三)	44,580	-	-	44,580	40,890	36.38 %	14,876	556,957	787,814
深圳鼎貫	條碼印表機及其零件之銷售	4,439	(三)	4,577	-	-	4,577	926	36.38 %	337	12,617	-

註1：透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司。

2.赴大陸地區投資限額：

本期期末累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額	經濟部投審會核准投資金額	依經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額
979,831	1,930,871	4,340,705

3.與大陸被投資公司間之重大交易事項：

合併公司民國一一年一月一日至六月三十日與大陸投資公司直接或間接之重大交易事項於編製合併報告時業已沖銷，請詳「重大交易事項相關資訊」之說明。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(四)主要股東資訊：

單位：股

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例
鼎翰科技股份有限公司		14,800,000	5.61 %

註：(1)本表主要股東資訊係由集保公司以每季底最後一個營業日，計算股東持有公司已完成無實體登錄交付(含庫藏股)之普通股及特別股合計達百分之五以上資料。至於公司財務報告所記載股本與公司實際已完成無實體登錄交付股數，可能因編製計算基礎不同或有差異。

(2)上開資料如屬股東將持股交付信託，係以受託人開立信託專戶之委託人個別分戶揭示。至於股東依據證券交易法令辦理持股超過百分之十之內部人股權申報，其持股包括本人持股加計其交付信託且對信託財產具有運用決定權股份等，有關內部人股權申報資料請參閱公開資訊觀測站。

十四、部門資訊

合併公司營運部門資訊及調節如下：

	111年4月至6月			
	整流器部門	條碼印表機部門	調整及銷除	合計
收 入				
來自外部客戶收入	\$ 1,922,419	2,042,284	-	3,964,703
部門間收入	1,754,881	-	(1,754,881)	-
收入合計	<u>\$ 3,677,300</u>	<u>2,042,284</u>	<u>(1,754,881)</u>	<u>3,964,703</u>
應報導部門損益	<u>\$ 438,405</u>	<u>411,760</u>	<u>(37,000)</u>	<u>813,165</u>
	110年4月至6月			
	整流器部門	條碼印表機部門	調整及銷除	合計
收 入				
來自外部客戶收入	\$ 1,495,497	1,735,886	-	3,231,383
部門間收入	1,507,679	-	(1,507,679)	-
收入合計	<u>\$ 3,003,176</u>	<u>1,735,886</u>	<u>(1,507,679)</u>	<u>3,231,383</u>
應報導部門損益	<u>\$ 183,427</u>	<u>299,069</u>	<u>(20,400)</u>	<u>462,096</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

		111年1月至6月			
		整流器部門	條碼印表機 部 門	調整及銷除	合 計
收 入					
來自外部客戶收入	\$	3,912,264	3,804,367	-	7,716,631
部門間收入		3,503,659	8	(3,503,667)	-
收入合計	\$	<u>7,415,923</u>	<u>3,804,375</u>	<u>(3,503,667)</u>	<u>7,716,631</u>
應報導部門損益	\$	<u>902,247</u>	<u>633,111</u>	<u>(37,000)</u>	<u>1,498,358</u>
		110年1月至6月			
		整流器部門	條碼印表機 部 門	調整及銷除	合 計
收 入					
來自外部客戶收入	\$	2,849,118	3,260,827	-	6,109,945
部門間收入		2,894,737	42	(2,894,779)	-
收入合計	\$	<u>5,743,855</u>	<u>3,260,869</u>	<u>(2,894,779)</u>	<u>6,109,945</u>
應報導部門損益	\$	<u>348,074</u>	<u>539,544</u>	<u>(20,400)</u>	<u>867,218</u>
應報導部門資產					
111年6月30日	\$	<u>23,763,768</u>	<u>8,145,755</u>	<u>(14,395,745)</u>	<u>17,513,778</u>
110年12月31日	\$	<u>21,448,464</u>	<u>7,670,091</u>	<u>(13,132,584)</u>	<u>15,985,971</u>
110年6月30日	\$	<u>20,099,311</u>	<u>7,576,969</u>	<u>(12,328,392)</u>	<u>15,347,888</u>